

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2026-038

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

随着公司业务规模扩张迅速，流动资金需求也有所增加，公司为满足经营发展需要，拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 30,000.00 万元综合授信额度，授信方式为质押融资。在授信有效期内，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的法律文件。

主要融资方式：用于办理包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、出口押汇、国内信用证、保函、商业票据贴现、商业汇票保贴、免保证金外汇衍生品、敞口资产池、供应链融资、应收账款电子凭证质押融资等综合授信业务。资金用途为补充日常经营所需流动资金。

具体授信业务品种、额度、期限和利率，以公司与银行签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日，该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会第五次会议审议，表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次新增银行授信额度符合公司生产经营和业务发展需求，有助于改善公司当前现金流量及财务状况，对促进公司业务发展、提高综合竞争力等方面具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日